EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04163988

PUBLICATION DATE

09-06-92

APPLICATION DATE

29-10-90

APPLICATION NUMBER

02291166

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

INVENTOR: GOTO KENJI;

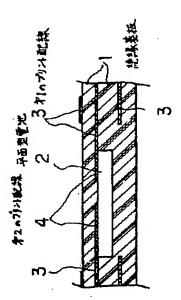
INT.CL.

H05K 1/18 H01M 2/10 H05K 3/46

TITLE :

: PRINTED WIRING BOARD WITH

BUILT-IN BATTERY



PURPOSE: To achieve high densities of wiring and mounting by integrally mounting a flat surface type battery therein.

CONSTITUTION: A thermoplastic resin film in which first printed wirings 3 are arranged, is aligned to a flat surface type battery 2 in which second printed wirings 4 are arranged, predetermined number of films are superposed, thermally press-molded to obtain a desired battery-containing type printed circuit board. That is, a battery-containing type printed circuit board in which the thermoplastic resin film for forming an insulating base material 1 is melted, plastically deformed at the stage of thermally press-molding, the material 1, the wirings 3, 4 are rigidly and effectively integrated, can be easily obtained.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

_404163988A_AJ_>

1B日本国特許庁(JP).

⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A)

平4-163988

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月9日

H 05 K 1/18 H 01 M 2/10 H 05 K 3/46

Z 6736-4E B 6813-4K Q 6921-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❸発明の名称

電池内装型プリント配線板

②特 顧 平2-291166 ②出 顧 平2(1990)1

②発明者後藤

顧 平2(1990)10月29日

東京都府中市東芝町 1 株式会社東芝府中工場内

切出 願 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 須山 佐一

男 一 新

1. 発明の名称

電池内袋型プリント配線板

2. 特許請求の範囲

熱報基板と、前記器線基板の所定領域に内装された平面型電池と、前記器線基板の少なくとも 所定領域周辺部に配設された第1のプリント配款と、前記平面型電池の少なくとも一主面に配設された第1のプリント配款された配款に電気的に接続する第2のプリント配線とを具備して成ることを特徴とする電池内装型プリント配線板。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)・

本発明は電池内装型プリント配線板に係り、 特にカード用などに適する電池内装型プリント配 線板に関する。

(従来の技術)

電子摘器類のコンパクト化ないし軽量化を目

的として、回路機構の軽小化もしくは薄型化も推 達されている。たとえば各種のカード用混成回路 装置においては、厚さ 8.2 mm程度に薄型化されて おり、したがって所要の混成回路装置の構成に使 用するプリント配線板についても、その配線の高 密度化および薄型化が必然的に望まれている。

また、この種の混成回路装置ないし実装回路基板においては、いわゆる駆動電源を内袋させ使用の筋便化を図ることも知られている。すなわちないの筋関係を図ることも知られている。本地を予位を表して、たとえばボタン型電流を展示を受ける。などの種の数質としては、たとえば携帯は電点などが例示される。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記ボタン型電池を内袋(内蔵)させた選成回路装置においては、駆動器である電池を、たとえば半導体素子と同様に一実装部品として実装する構成を採っている。このため、 実装用プリント記練板においても、前記駆動車と しての電池を実装する領域を新たに要することになる。ところで、前記電池の実装領域新設は、プリント配線板自体についてみると、プリント配線領域や他の電子部品の実装領域を低減することになり、結果的には混成回路装置の高密度化もしくは軽小・薄型化などが損なわれるという問題がある。

本発明は上記事情に対処してなされたもので、 配線の高密度化が図られ軽小・薄型化された混成 回路装置の構成に適する電池内装型プリント配線 板の提供を目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明に係る電池内装型プリント配線板は、 絶縁基板と、前記絶縁基板の所定領域に内装され た平面型電池と、前記絶縁基板の少なくとも所定 領域周辺部に配設された第1のプリント配線と、 前記平面型電池の少なくとも一主面に配設され 記所定領域周辺部に配設された第1のプリント配線と 線に電気的に接続する第2のプリント配線とを具

少なくとも一主面に配設され前紀所定領域周辺部に配設された第1のブリント記線(クロック信号回路)3に電気的に接続するた第2のブリント配線であり、たとえば前記平面型電池2の端子と第1のブリント配線(クロック信号回路)3とを電気的に接続するものである。

確して成ることを特徴とする。

(作用)

上記構成においては、駆動顔としての平面型電池が、プリント配線板内に一体的に内装(内蔵)されるとともに、その平面型電池の外表面もプリント配線を担持ないし支持する機能を呈する。つまり、駆動電顔たる平面型電池は、別途面実装領域を要しないばかりでなく、外表面がプリント配線面とし機能するため、配線の高密度化および実装の高密度化も達成される。

(実施例)

以下、第1図を参照して本発明の実施例を説明する。第1図は本発明に係る電池内装型ブリント配線板の構成例を断面的に示したもので、1は絶縁基板、2は前記絶縁基板1の所定領域に内袋された平面型電池、たとえばペーパー型(チップ型)電池もしくはボタン型電池である。また3は前記絶縁基板1の少なくとも所定領域周辺部に配設された第1のプリント配線、たとえばクロック信号回路である。さらに4は前記平面型鉱池2の

線に接続して、所要の電子回路を構成するもので ある。

上記のようにして第1のプリント配線を配設し た熱可塑性樹脂フイルムおよび第2のプリント配 線を配設した平面型電池を位置合わせし、所要枚 数を重ね合わせて加熱加圧成型することによって、 所望の電池内装型プリント配線板が得られる。つ まり、前記加熱加圧成型の段階で、絶縁基材を成 す熱可塑性樹脂フィルムが溶着および塑性変形し、 絶録基材、第1のプリント配線、平面型電池およ び第2のプリント配線が強固かつ確実に一体化し て成る電池内装型プリント配線板を容易に得るこ とができる。なお、上記加熱加圧成型に当たって、 平面型電池面(外表面)に配設されたプリント配 線(第2のプリント配線)と、この平面型電池の 内装 (内蔵) 予定領域の周辺部に配設された第1 のプリント配線とをより確実に接続するため、そ の接続部に導電ペーストなどを別途介在させてお

上記では、絶縁基材を熱可塑性樹脂フイルムで

構成した例を示したが、絶縁基材は熱硬化性樹脂で構成してもよく、また第1のプリント配線の形成は、たとえば銅箔の選択的エッチングなどによってもよい。

[発明の効果]

上記説明したように本発明によれば、駆動がは、ないの平面型電池が、ブリント配線板内に型を抱抜って、ための平面型である。とともに、そので重要を担持ないして、ないの外表面もブリント配線を担持ないのでは、取動がある。のでは、ないのではないのでは、ないのではないのでは、ないでは、ないではないでは、ないでは、ないではないでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ない

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る電池内装型プリント配 線板の構成例を示す断面図である。

1 … … 艳禄基板

2 … … 平面型電池

3 … … 第 1 の プ リ ン ト 配 線 4 … … 第 2 の プ リ ン ト 配 線

第1図